



應徵項目：資深軟體工程師

資訊技能：高低階程式語言 (Assembly, C/C++, Java, QBasic)

常見 scripts (Bash, Python)

網頁前後端 (HTML/CSS/js, VPS, clouds)

工作簡歷：

探宇科技公司 - 軟體副工程師、軟體工程師 (1999/6~2004/7)

- 五人團隊花費三年開發商用資料探勘 (data mining) 套裝軟體
- 獲「經濟部創新軟體創意大賽」佳作。獲選為「微軟企業應用解決方案」

交通大學 - CM-VLSI 實驗室工程師、助理 (2005/1~2008/6)

- 開發「國科會計畫之 VLSI 晶片電熱模擬」軟體
- CM-VLSI 實驗室助理

華寶通訊 (上市) - 軟體工程師 (2009/1~2012/11)

- 開發、測試及除錯 Android 與驅動程式 driver
- 開發手機出貨預裝 apps

鴻志資訊 - 軟體工程師 (2013/1~2016/6)

- 開發分散式 3D 飛機貨艙物品最佳化系統
- 航運某客戶使用後，裝載率增加 15%，整體營收單月成長 5,800 萬元

和蓮光電 - 軟體工程師 (2016/9~2020/5)

- 開發 MicroLED 面板、微控器韌體、調整校準軟體 (Python, GUI, WebSocket)
- 管理公司內外網站與售後支援平台

ASML - 軟體工程師 (駐點派遣) (2020/8~)

- 開發高速電腦叢集應用軟體 (C++)

競賽與榮譽：

教育部	高中學科能力競賽	資訊學科	台南縣市第一名
教育部	高中學科能力競賽	資訊學科	台灣南區第一名
教育部	高中學科能力競賽	資訊學科	台灣全區第四名
教育部	ACM 程式設計競賽	交通大學校隊	校隊選手 ('98 屆)
教育部	ACM 程式設計競賽	交通大學校隊	校隊選手 ('99 屆)
經濟部	第一屆創新軟體系統創意大賽		佳作

教育程度：

交通大學電機學院碩士 (2004/9~2008/6)

交通大學資訊科學系(1995/9~1999/6)

論文著作：

1. “[Full-Chip Thermal Analysis for the Early Design Stage via Generalized Integral Transforms](#)”, *IEEE Asia South Pacific Design Automation Conference*, 2008.
2. “[Hierarchical Power Delivery Network Analysis Using Markov Chains](#)”, *IEEE International SOC Conference*, 2007.

自傳：

您好！我是林泓涓，家中有父母及一個妹妹。家庭小康，衣食無虞，我和妹妹在父母的呵護下長大成人，家庭氣氛和樂。

我是花蓮出生的孩子，國小搬到台南。就讀新竹交通大學資訊科學系。業界工作多年，再返回交通大學就讀電機研究所。

興趣是看書、上網，喜歡研究電腦技術。休閒時間會聽音樂，但很少看電視。另外一項休閒則是吃遍各地小吃，滿足味蕾。

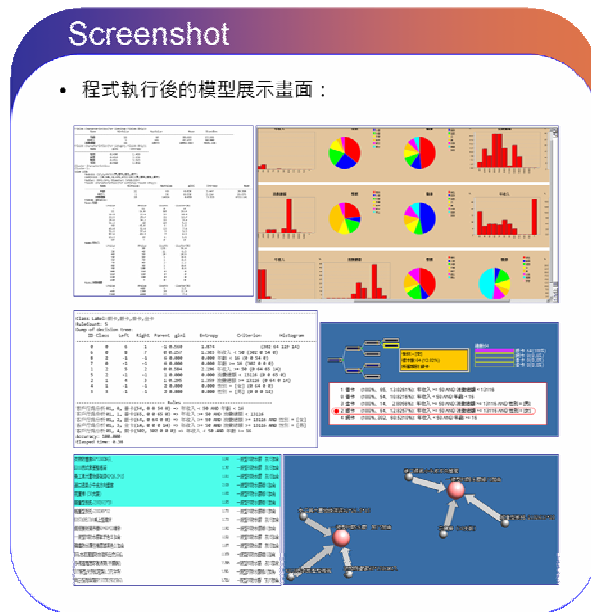
個性偏內向（土象的金牛），但認真堅毅、誠懇信實，跟同事都能相處融洽。常替同事解決工作上的困難，所以人緣很好。

希望在人生的這個階段，能在職場上更進一步，在新的職位上貢獻所長。

附錄：作品集

探宇科技

- 專案名稱：UniMarketing
- 上到下分別是分群 (k-means clustering)、分類 (decision-tree classification)、關連規則 (association rules)



- 左側是模型報表，右側是「視覺化模型」(Visualization) 簡明易懂
- ODBC&JDBC 串連至 ETL、數值統計、資料清理
- 經濟部第一屆「創新軟體創意大賽」佳作

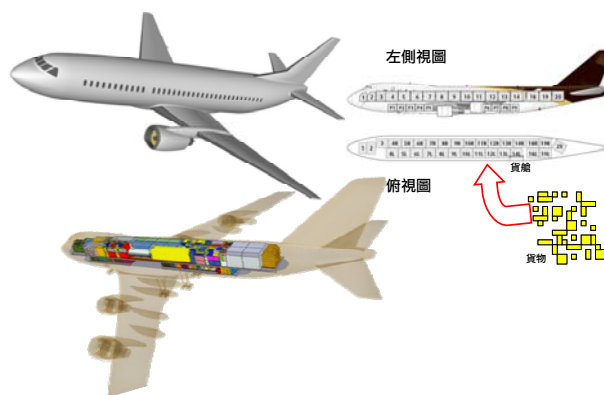


- 每套市價 800 萬元
- 負責範圍：軟體開發 (超過 30 萬行程式碼)、CVS 版本控制、JVM Bytecode 編譯、利用混淆器擾亂 .class、產品 ship 前之安裝程式建置 (InstallShield script) 及版本凍結、refactoring 重構。

附錄：作品集

鴻志資訊

- 專案名稱：分散式 3D 飛機貨艙物品最佳化系統。
- 開發工具為 .Net、C#、MFC、Silverlight，以 1 年多時間，與三位同仁一起開發。
- 某航運客戶使用後，裝載率增加 15%，單月營收成長 5,800 萬元。
- 以最佳化引擎為核心，幫助客戶計算在給定空間內，如何達到裝載率最高且安全（某些化學物質不可放置在相同空間）。



貨品、貨櫃、貨艙、樓層、貨機、貨品機內擺置，順序示意圖

交通大學 CM-VLSI 實驗室

- 專案名稱：基於泛式積分轉換法的晶片熱度分析。
- 計算解析解為基礎之電路熱分佈模擬器（以 C++ 撰寫）。
- 傳統元件增加，計算量與記憶體之 complexity 呈指數成長。此套軟體呈線性成長。
- 開發環境為《 Sun Blade 1500 Workstation 》與 GNU 的 GCC。

